2017년 IDEC MPW 지원 내역 및 일정

2017년 MPW 지원 내역

회사	공정[㎛]	공정내역	설계면적 (팀별)	칩수/ 1회	모집 횟수	Package 사용 가능 pin 수(Design)
삼성	65nm RFCMOS	CMOSRF 1-poly 8-metal	4mmx4mm	40	1	208pin
매그나칩/ SK하이닉스	180nm CMOS	CMOS 1-poly 6-metal (6metal을 Thick metal (TKM)로만 사용가능) (Optional layer(DNW,HRI,BJT,MIM) 추가)	3.8mmx3.8mm	25	5	200pin
	350nm CMOS	CMOS 2-poly 4-metal (Optional layer(DNW,HRI,BJT,CPOLY)추가)	5mmx4mm	20	2	144pin

- 지원 내역은 공정사의 사정에 따라 변경될 수 있음.

참여 대상

- IDEC참여대학의 학부 및 대학원생

진행 일정

회차구분 (공정_년도순서)	우선모집 (모집마감)	정규모집 (모집마감)	제작 칩수	DB 마감 (Tape-out)	Die-out	공정
S65-1701		2017.01.23	40	2017.05.22	2017.12.11	삼성 65nm
S65-1702		2017.03.13	40	2017.09.04	2018.03.26	
S65-1703	2017.04.10	2017.06.19	40	2018.01.08	2018.07.30	
MS180-1701		2017.01.23	25	2017.03.20	2017.08.21	매그나칩/SK하이닉스 180nm
MS180-1702		2017.02.20	25	2017.05.22	2017.10.23	
MS180-1703		2017.03.13	25	2017.07.24	2017.12.26	
MS180-1704	2017.02.20	2017.04.10	25	2017.09.18	2018.02.19	
MS180-1705	2017.04.10	2017.06.12	25	2017.12.04	2018.05.07	
MS350-1701		2017.02.20	20	2017.06.12	2017.10.02	매그나칩/SK하이닉스 350nm
MS350-1702	2017.05.08	2017.07.10	20	2018.01.15	2018.05.07	

- 위의 일정은 공정사의 사정에 따라 변경될 수 있음.
- 회차 표기 방법 변경 : "공정코드-년도모집순서"(예시)삼성65nm 2017년 1회차 : S65-1701)
- 삼성 65nm 1회차(S65-1701)의 경우는 기존 설계 진행으로 서버를 보유한 팀만 접수 가능합니다.
- **모집** : 우선과 정규모집으로 구분. 정규모집까지 마감되지 않는 공정에 대해서는 추가 모집 진행
  (* 신청접수 기간 : 모집 마감일 2주전부터 접수)
- **선정결과** : 모집마감후 15일내 개별 통보
- **설계설명회** : 회차별 정규모집 마감 후 1~2주내 개최
- **Package 제작** : Die out 이후 1개월 소요됨.

문의처 :042-350-4428, yslee@idec.or.kr(이의숙 책임) http://www.idec.or.kr

반도체설계교육센터
IC DESIGN EDUCATION CENTER